

# 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

**保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年10月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕6号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股票数量为1,731.4716万股，占发行后发行人总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为259.7206万股，占发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,030.2510万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为441.5000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年2月7日（T-1日）9:00-12:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人：** 龙迅半导体（合肥）股份有限公司

**保荐机构（主承销商）：** 中国国际金融股份有限公司

2023年2月6日

（此页无正文，为《龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：龙迅半导体（合肥）股份有限公司



2023年2月6日

（此页无正文，为《龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国



2023年 2月 6日